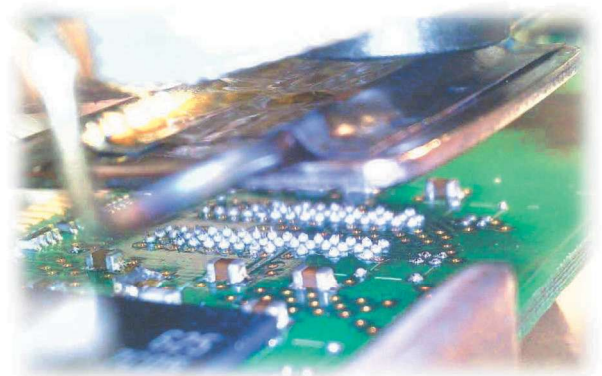


BGA剥離機



NEW 型式：HIH-70シリーズ 特許出願済

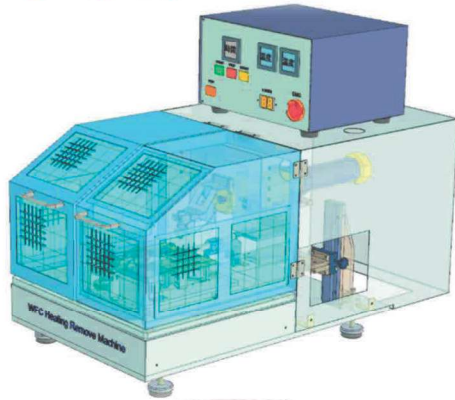
BGA
取り外し
できます。



『電磁誘導加熱が不可能を可能に』

リワーク革命

IH硬化接着剤で実現！！



工法

工程

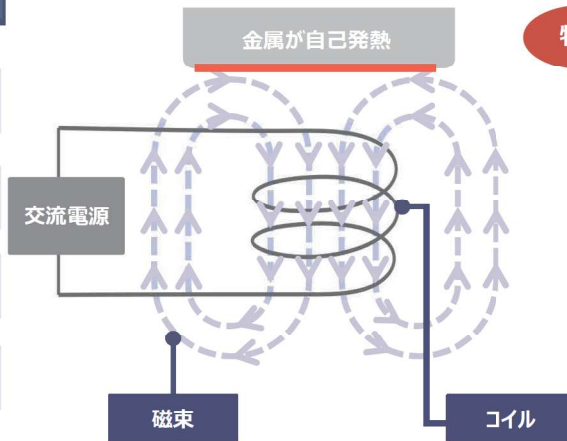
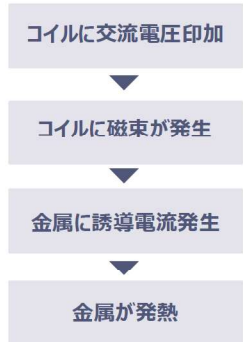
BGA CSP チップレットへの適応

素子サイズ	5 x 5 ~ 50 x 50mm
マシンサイズ	400W x 770D x 400H
重量	40kg
ユーティリティ	AC100V 15A

接着剤

接着剤

電磁誘導加熱とは？



特長

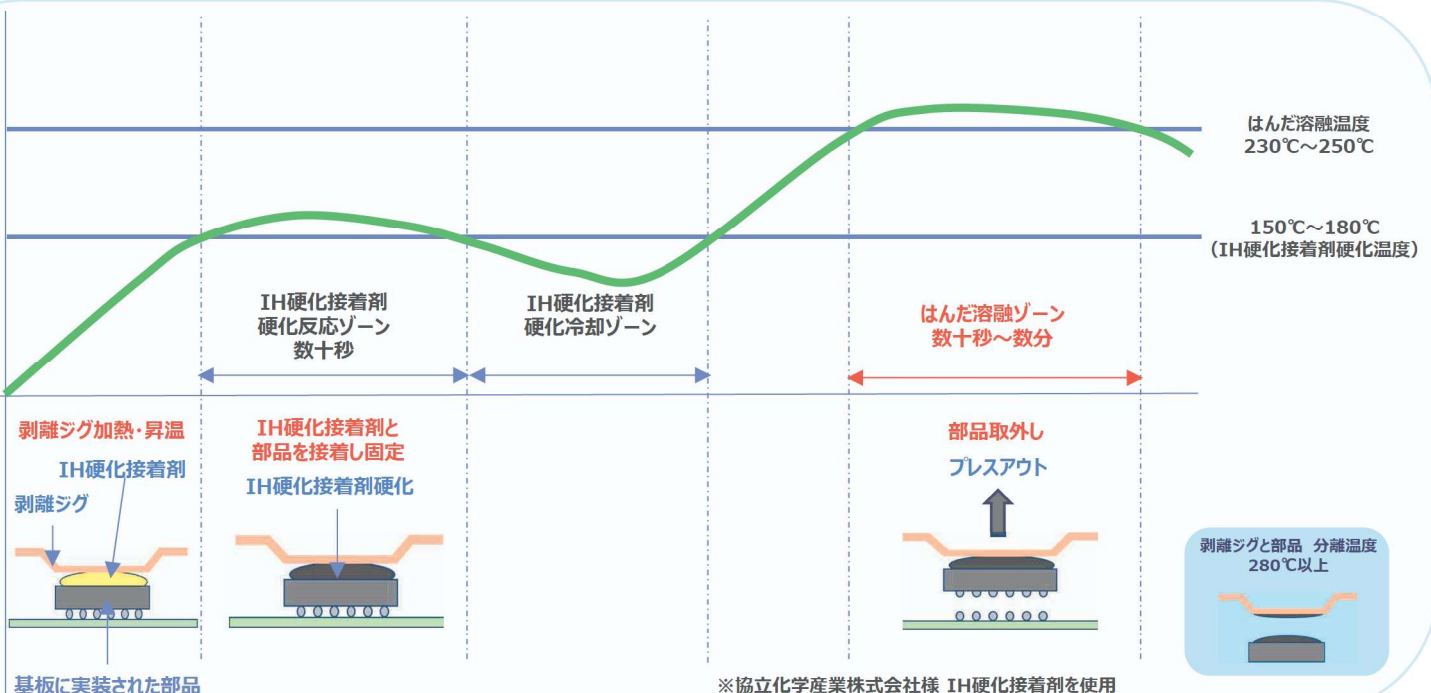
協立化学産業株式会社
KYORITSU CHEMICAL & CO., LTD.

- ① BGA剥離機の電磁誘導加熱によって、はんだの熔融温度よりも低温域で数十秒で硬化し金属製剥離ジグを接着します。
- ② 即時硬化で高耐熱性を有する接着剤を用いてBGAの加熱、除去を行います。
- ③ 除去後にBGAに付着した接着剤の除去も可能です。



温度プロファイルイメージ

図による工程解説



株式会社ワンダーフューチャーコーポレーション
〒130-0003 東京都墨田区横川1-16-3センターオブガレージ
電話番号：03-4500-2708

Eメール：info@sp.wonderf-c.com
ホームページ：https://wonderf-c.com

株式会社ワンダーフューチャーコーポレーション甲府開発センター
〒400-0026 山梨県甲府市塩部2-7-29朝日ビル1階
電話番号：055-234-5805

